

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	<u>2025年12月26日</u> 诺安基金、平安养老、财信证券、华泰资管、银河证券、中金资管等 <u>2025年12月28日</u> 博时基金、东方阿尔法基金、海富通基金、金鹰基金、鹏华基金、太平养老保险、新华基金、易米基金等
时间	2025年12月26日、2025年12月28日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	

公司介绍

芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。此外，根据 IPnest 在 2025 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是 2024 年中国大陆排名第一、全球排名第八的半导体 IP 授权服务提供商；2024 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的报告和企业公开数据，在全球排名前十的 IP 企业中，芯原的 IP 种类排名前二。

根据公司披露的《关于新签订单的自愿性披露公告》，2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日，公司 2025 年第四季度新签订单 24.94 亿元，

	<p>较去年第四季度全期大幅增长 129.94%，较今年第三季度全期进一步增长 56.54%，继 2025 年第二、三季度单季度新签订单屡创历史新高后，再创历史单季度新高，将为公司未来营业收入增长提供有力的保障。截至 2025 年 12 月 25 日，公司第四季度新签订单金额中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，AI 算力相关订单占比超 84%，数据处理领域订单占比近 76%。上述新签订单数据为公司内部统计，公司业绩情况以公司最终披露的定期报告为准。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：请问公司如何看待未来研发投入变化趋势？</p> <p>回复：芯原所处的集成电路设计行业，是集成电路产业的上游行业，相对产业链中其他行业而言，需要更早地进行针对性的布局和研发。因此集成电路设计行业呈现投资周期长，研发投入大的行业格局。通过 20 余年的高研发投入和深度积累，公司已经在半导体 IP 和芯片定制领域形成了丰富的技术池和服务经验。未来，随着公司芯片设计业务订单增加，预计未来公司会将更多研发资源投入客户项目，研发投入占营业收入比重将有所下降。</p> <p>问题：请问公司新签订单中 AI 算力相关领域属于云侧还是端侧？</p> <p>回复：截至 2025 年 12 月 25 日，公司第四季度新签订单 24.94 亿元，其中 AI 算力相关订单占比超 84%，包括云侧和端侧 AI 相关项目。公司基于领先六大处理器 IP 和先进的芯片定制能力，不断强化公司在 AI ASIC 领域的核心竞争力，涵盖数据中心、服务器等高性能云侧计算设备以及实时在线、超低能耗的端侧设备；不仅在 AI PC、AI 手机等存量市场，而且在 AI 眼镜、AI 玩具、AI Pad 等增量市场开发更先进的核心 IP，打造更完整的芯片设计平台。例如，三年前，芯原帮国际互联网企业做 AR 眼镜系统芯片，积累了关键项目经验；去年起，公司开始将 AI 技术应用于新兴的玩具与互动娱乐领域，积极开拓 AI 端侧的增量市场。</p>

问题： 请问逐点和公司有哪些业务协同？

回复： 公司公告拟以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体的控制权。逐点半导体于 2004 年在张江成立，专注于移动设备视觉处理芯片、视频转码芯片和 3LCD 投影仪主控芯片及实施方案的开发和设计，是全球先进的创新视频、显示处理芯片和解决方案提供商，拥有 160 多项国内外发明专利。该项收购对公司业务布局有以下意义：

一是双方的互补协同，可强化公司视觉处理领域技术优势，进一步提升公司在端侧和云侧 AI ASIC 市场竞争力。公司在图像前处理领域技术领先，逐点半导体主要擅长图像后处理，双方的客户群体基础高度重合、双方 IP 和技术形成互补。本次收购完成后，公司的图像前处理 IP 与逐点半导体的图像后处理 IP 相结合，将为手机客户提供一套完整的图像处理方案，提升公司在显示后处理 IP 领域的竞争力；此外，还有助于公司在 AI 手机、AI 眼镜、AI 电视、AI Pad、AI 投影等更多领域，拓展终端 AI ASIC 项目。

二是通过分布式渲染与 GPU 的结合，加强公司在端侧和云侧 AI ASIC 的布局。在云游戏及专业显示等领域，先进的视觉处理与显示技术是提升用户体验、实现差异化竞争的核心。公司在 GPU、NPU、VPU 等处理器 IP 领域已具备长期的技术积累和领先的行业地位。逐点半导体在 AI 图像增强领域技术领先，其与公司的 GPU IP 深度融合，可以颠覆性创新的分布式渲染架构，通过专用芯片的加速，提供强大的图像处理能力，实现出色的能效表现，显著降低 GPU 算力需求。

此外，逐点半导体日前推出的空间媒体技术平台将 AI 与独特的三维重建算法相结合，可实现快速建模并以低功耗进行实时渲染的性能跃升。通过此项革命性的技术突破，双方已与互联网厂商联合开发云端应用，将广泛应用于数据中心、云游戏、短视频、影视等领域。公司将持续投入研发，构建软硬件一体化的系统方案，推动该技术在智慧教育、智慧医疗、

智慧出行和人形机器人等更多场景中的应用扩展。

问题：请问公司目前在手订单情况如何？

回复：截至今年三季度末，公司在手订单 32.86 亿元，已连续八个季度保持高位。公司 2025 年第三季度末在手订单中，一站式芯片定制业务在手订单占比近 90%，且预计一年内转化的比例约为 80%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。截至 12 月 25 日，公司第四季度新签订单 24.94 亿元，再次创下历史新高，在手订单预计将保持高位。

问题：请问公司在 Chiplet 技术上有哪些布局？

回复：Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，目前，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制业务的产业价值，拓展市场空间。

公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，目前正在推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。目前公司已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP（System in Package）先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWos 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCIE 物理层接口，相关测试芯片已完成流片，正在实验室进行测试，目前进展顺利；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯

	<p>原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。</p>
--	--